固溶时效态 Ti-Ni 合金相变行为与 Ni 含量的关系 *

贺志荣 1.2) 周敬恩 1) 宫崎 修一 3)

1) 西安交通大学金属材料强度国家重点实验室, 西安 710049

2) 陕西理工学院材料科学与工程系, 汉中 723003

3) 筑波大学物质工学系, 茨城县 305-8573, 日本

摘 要 固溶淬火态 Ti_{100-x}Ni_x 合金中, x=40.0-49.0 时, 合金的马氏体相变 (MT) 温度 ($T_{\rm M}$)、热滞 ($\Delta T_{\rm M}$) 不变, 相 变热 ($\Delta H_{\rm M}$) 升高; x=49.0-52.0 时, 合金的 $T_{\rm M}$ 和 $\Delta H_{\rm M}$ 急剧下降, $\Delta T_{\rm M}$ 急剧升高; x=52.0-56.0 时, 合金的 $T_{\rm M}$ 和 $\Delta H_{\rm M}$ 升高, $\Delta T_{\rm M}$ 降低; x=56.0-70.0 时, 合金的 $T_{\rm M}$ 和 $\Delta T_{\rm M}$ 变化不大, $\Delta H_{\rm M}$ 下降. 673 K 时效态 Ti_{100-x}Ni_x 合金中, x=40.0-50.0 时, 合金发生 MT, 不存在时效效应; x=50.5-70.0 时, 合金既发生 MT 又发生 R 相相变 (RT) 且具有时效效应. 随时效时间 ($t_{\rm A}$) 延长, $T_{\rm M}$ 和 $\Delta H_{\rm M}$ 先下降后上升, $\Delta T_{\rm M}$ 下降. $T_{\rm R}$ 随 x 增加保持不变, 随 $t_{\rm A}$ 延长而 升高. $\Delta T_{\rm R}$ 对 x 和 $t_{\rm A}$ 不敏感. $\Delta H_{\rm R}$ 对 x 和 $t_{\rm A}$ 都十分敏感. x=40.0-50.0 和 x=50.5-70.0 合金的室温组织分别为 M+TiNi₂ 和 A(母相)+ 析出物. 随 x 增加或 $t_{\rm A}$ 延长, x=50.5-70.0 的合金中析出物数量增多.

关键词 Ti-Ni 合金,形状记忆合金,固溶处理,时效,相变 中图法分类号 TG115 **文献标识码** A **文章编号** 0412~1961(2003)06-0617-06

RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATION BEHAVIORS AND Ni CONTENT IN SOLUTION– AGED Ti–Ni ALLOYS

HE Zhirong^{1,2)}, ZHOU Jing'en¹⁾, Miyazaki Shuichi³⁾

1) State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049

2) Department of Materials Science and Engineering, Shaanxi University of Technology, Hanzhong 723003

3) Institute of Materials Science, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305–8573, Japan

Correspondent: HE Zhirong, professor, Tel: (0916)2113982, E-mail: jezhou@mail.lib.xjtu.edu.cn Supported by Key Natural Science Foundation of Education Bureau of Shaanxi Province

(No.95JZK14) and China Scholarship Council

Manuscript received 2002-08-22, in revised form 2002-11-06

ABSTRACT For the solutionquenched $Ti_{100-x}Ni_x$ alloys, when x=40.0-49.0, the martensitic transformation (MT) temperature (T_M) and temperature hysteresis (ΔT_M) of alloys are constant, and the MT heat (ΔH_M) of alloys increases with in creasing x; when x=49.0-52.0, the T_M and ΔH_M decrease, and the ΔT_M increases drastically; when x=52.0-56.0, the T_M and ΔH_M increase, and the ΔT_M decreases; when x=56.0-70.0, the T_M and ΔT_M are nearly of no change, and the ΔH_M decreases. When x=40.0-50.0 for the 673 K aged $Ti_{100-x}Ni_x$ alloys, the MT occurs in alloys which have no aging effects; when x=50.5-70.0, the MT and the R phase transformation occur in alloys which have aging effects. The T_M and ΔH_M decrease first and then increase, and ΔT_M decreases with increasing aging time (t_A) . The T_R is not sensitive to x, but sensitive to t_A . The T_R is constant with increasing x, and increases with increasing t_A . The ΔT_R is constant and not sensitive to x and t_A . The ΔH_R is extremely sensitive to x and t_A . When x=40.0-50.0 and x=50.5-70.0, the room temperature microstructures of Ti–Ni alloys are M with TiNi₂, and A (parent phase) with precipitates, respectively. When x=50.5-70.0, the volume fractions of precipitates in Ti–Ni alloys increase with increasing x or t_A .

KEY WORDS Ti-Ni alloy, shape memory alloy, solution treatment, aging, phase transformation

收到初稿日期: 2002-08-22, 收到修改稿日期: 2002-11-06 作者简介: 贺志荣, 男, 1960年生,教授,博士生 形状记忆合金 (SMA) 具有记忆给定形状的能力. 在 SMA 中, Ti-Ni 合金的形状记忆效应 (SME) 和超弹性 (SE) 特性良好. 该合金的 SME 和 SE 来源于马氏体相 变 (MT) 和 R 相相变 (RT)^[1].

^{*} 陕西省教育厅重点科研基金项目 95JZK14 和国家留学基金管理 委员会资助

为了理解和改进 Ti-Ni 合金的 SME 和 SE, 人们已 就成分^[2,3], 热处理^[4,5], 冷、 热加工^[6-8] 和热循环^[9,10] 等对近等原子比 Ti-Ni 合金的 MT 和 RT 行为的影响进 行了大量研究,根据成分或热处理不同, Ti–Ni 合金冷 却时可以发生一阶段 A-M 相变, 也可以发生二阶段 A-R-M 相变, 甚至三阶段 A-R-M1-M2 相变 [11]. 其中 A 代表母相 B2(CsCl 型结构); M 代表马氏体 B19'(单斜结 构); R 代表 R 相 (菱方结构)^[12]. 不管那种相变都与 B2 相有关,由 Ti-Ni 二元合金相图可知,出现 B2 相的 Ni 含量范围是 33.3%—75.0%(原子分数)^[3]. 目前对该成分 范围 Ti-Ni 合金相变行为的系统研究尚不多. 尽管文献 [13] 对 Ti--(33.3%—75.0%)Ni 合金的相变行为进行过报 道,但对该合金的组织和相变行为与 Ni 含量和时效时间 (t_A)的关系尚未进行系统的分析评价.本文旨在系统研 究 Ni 含量和 t_A 对固溶、时效态 Ti-(33.3%—75.0%)Ni 合金组织和相变行为的影响.

1 实验方法

以纯度为分别为 99.7% 和 99.9%(质量分数)的海绵 钛和电解镍为原料,在氩气保护下,用电弧熔炼法制作了 20 种 Ti_{100-x}Ni_x (x=33.3, 40, 45, 48, 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, 51.5, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 65, 70 和 75, 原子分数,%)合金.为确保成分均匀,合金铸块在水冷铜 坩锅中至少反复熔化 6 次.在熔炼过程中用纯 Ti 作为杂 质气体的吸收剂.试样从铸块中心截取,封入真空石英管 中,在 973 K 进行 1 h 固溶处理后水冷;将部分固溶淬火 试样封入真空石英管中,在 673 K 分别进行 0.5—100 h 时效处理后水冷.

利用 Shimadzu DSC-50 型示差扫描量热仪 (DSC) 分析合金的相变行为 (相变温度、热滞和相变热),温度范 围为 150—400 K,加热冷却速率为 10 K/min. 用 MEF3 型光学显微镜 (OM) 和 Hitachi S-2700 型扫描电子显微 镜 (SEM) 及其配置的能谱仪 (EDXS) 分析合金的组织,

腐蚀剂为 HF : HNO₃ : H₂O=1 : 4 : 5 (体积比). 为减少测量误差,用 DSC 曲线上相变峰温度表示相

变温度,如 $T_{\rm M}$ 和 $T_{\rm A}$ 分别表示正、逆MT温度; $T_{\rm R}$ 和 $T_{\rm R}'$ 分别表示正、逆RT温度.用 $\Delta T_{\rm M}=T_{\rm A}-T_{\rm M}$ 和 $\Delta T_{\rm R}=T_{\rm R}-T_{\rm R}'$ 分别表示MT和RT热滞.用 $\Delta H_{\rm M}$ 和 $\Delta H_{\rm R}$ 分别表示M和和R

2 实验结果

实验表明, Ti₂Ni (x=33.3)和 TiNi₃ (x=75.0)合金 不发生相变; x=40.0—70.0的固溶淬火态和 x=40.0— 50.0的时效态 Ti-Ni 合金只发生 MT, 不发生 RT; x=50.5—70.0的时效态 Ti-Ni 合金既发生 MT, 又发 生 RT, 其中 673 K 短时间 ($t_A \le 1$ h)时效态 x=51.5— 70.0合金只发生 RT, 经过 5—10 h 时效后 MT 才出现. Ti-Ni 合金的典型 DSC 曲线在文献 [13, 14] 中已有详细

描述.

2.1 相变温度

相变温度的高低影响着 SMA 的应用范围. 图 1a 给 出了 x 和 t_A 对固溶时效态 Ti-Ni 合金 T_M 和 T_R 温 度的影响. 由于 673 K 短时时效态 x=51.5—70.0 合金 未发生 MT, 故图 1a 仅给出了固溶淬火态 ($t_A=0$ h), 在 673 K 下 10 和 100 h 时效态合金的 T_M 值 (以下所述的 热滞和相变热的情况相同).

由图可见, RT 存在于 x=50.5—70.0 合金中. $T_{\rm R}$ $x-t_{\rm A}$ 关系比较简单, $T_{\rm R}$ 温度几乎不随 x 的变化而变, 但 随 $t_{\rm A}$ 的延长而升高. 当 $t_{\rm A}$ 从 0.5 h 延长至 100 h 时, $T_{\rm R}$ 从 297 K 上升为 318 K. $T_{\rm M}-x-t_{\rm A}$ 关系比较复杂. 固溶淬 火态 Ti-Ni 合金的 $T_{\rm M}$ 与 x 的关系如下. x=40.0—49.0 合金的 $T_{\rm M}$ 很高且为定值 (342 K); x=49.5—50.0 合金 的 $T_{\rm M}$ 亦为定值 (313 K); x=50.0—52.0 合金的 $T_{\rm M}$ 对 x很敏感, x 每增加 1%, $T_{\rm M}$ 约下降 37—102 K; x=52.0— 56.0 合金的 $T_{\rm M}$ 随 x 的增加而直线升高; x=56.0—70.0 合金的 $T_{\rm M}$ 风为定值 (197 K). 时效态 x=40.0—50.0 合 金的 $T_{\rm M}$ 和 x 的关系与固溶淬火态合金相同. 673 K 时 效态 x=50.5—70.0 合金的 $T_{\rm M}$ 和 x 的关系与固溶淬火 态合金类似, 并受 $t_{\rm A}$ 影响. 随 $t_{\rm A}$ 延长, $T_{\rm M}$ 先下降后 上升.

2.2 热滞

热滞的大小影响着 SMA 的应用类型, 热滞小者作传 感元件, 热滞大者作联接元件 ^[15]. x 和 t_A 对固溶时效态 Ti-Ni 合金 MT 和 RT 热滞 ΔT_M 和 ΔT_R 的影响如图 1b 所示. 显然, RT 的显著特点是 ΔT_R 很小 (约 4 K), 且不随 x 和 t_A 的变化而变, 而 ΔT_M 比较大 (约 30 K) 且 $\Delta T_M - x - t_A$ 呈复杂的变化关系.

固溶淬火态 Ti-Ni 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 与 x 的关系如下: x=40.0—49.0 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 几乎保持定值 (约 32 K); x=49.0—50.5 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 随 x 增加而下降, 最小值 (约 23 K) 在 x=50.5 处取得; x=50.5—53.0 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 随 x 增加急剧升高, 在 x=53.0 处达最大值 (约 38 K); x=53.0—55.0 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 又直线下降; x=55.0—70.0 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 几乎保持定值 (约 33 K).

时效态 Ti-Ni 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 与 x 的关系与固溶淬火 态类似. x=40.0-50.0 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 与固溶淬火态相 同,为一定值且不受 $t_{\rm A}$ 影响. x=50.5-70.0 合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 受时效影响很大. 时效态合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 高于固溶淬 火态,随 $t_{\rm A}$ 延长 $\Delta T_{\rm M}$ 减少. 例如固溶淬火态 x=51.0合金的 $\Delta T_{\rm M}$ 为 25.2 K,而时效态 x=51.0 合金当 $t_{\rm A}$ 从 10 h 延长至 100 h 后, $\Delta T_{\rm M}$ 从 86 K 减少到 52 K.

2.3 相变热

相变热是用来衡量合金相变进行的程度,该值越大说 明相变进行得越充分^[6].图 1c 示出了 x 和 t_A 对固溶时 效态 Ti-Ni 合金 ΔH_M 的影响.固溶淬火态 Ti-Ni 合金



图 1 x 和 t_A 对固溶、时效态 Ti-Ni 合金相变行为的影响

Fig.1 Effects of x and aging time (t_A) on transformation behaviors of solution-quenched and aged $Ti_{100-x}Ni_x$ alloys (x is atomic fraction of Ni in Ti-Ni alloys)

(a) MT temperature (T_M) and RT temperature (T_R)

(b) MT temperature hysteresis ($\Delta T_{\rm M}$) and RT temperature hysteresis ($\Delta T_{\rm R}$)

(c) MT heat $(\Delta H_{\rm M})$ (d) RT heat $(\Delta H_{\rm R})$

的 $\Delta H_{\rm M}$ 与 x 的关系呈"双峰"状. 峰顶分别在 x = 49.0— 50.0 和 x = 55.0—56.0 处. 具体规律是:随着 x 增加, x = 40.0—49.0 合金的 $\Delta H_{\rm M}$ 直线上升,极大值 (26 J/g) 在 x = 49.0 处取得; x = 49.0—52.0 合金的 $\Delta H_{\rm M}$ 急剧下 降,极小值 (1.6 J/g) 在 x = 52.0 处取得; x = 52.0—55.0 合金的 $\Delta H_{\rm M}$ 又直线上升,极大值 (7.5 J/g) 在 x = 55.0少取得; x = 55.0—70.0 合金的 $\Delta H_{\rm M}$ 直线下降.时效态 Ti-Ni 合金的 $\Delta H_{\rm M}$ 与 x 的关系与固溶淬火态类似,也 呈 "双峰"状.随 $t_{\rm A}$ 延长,贫 Ni 峰的形状、尺寸基本 不变;富 Ni 峰则不断升高.亦即随 $t_{\rm A}$ 延长,贫 Ni 合金 的 $\Delta H_{\rm M}$ 基本不变,富 Ni 合金的 $\Delta H_{\rm M}$ 不断增加.从 $\Delta H_{\rm M}$ 看,贫 Ni 系中 x = 48.0—51.0 合金和富 Ni 系中 x = 55.0—56.0 合金具有较大的 M 相变能力.

x和 t_A 对时效态 Ti-Ni 合金 ΔH_R 的影响如图 1d 所示. 与 $\Delta H_M - x$ 关系类似, $\Delta H_R - x$ 关系也呈 "双峰" 状. 峰顶分别在 x=51.0和 x=56.0处. 随 t_A 延长, ΔH_R 增大. 从 ΔH_R 看, x=50.5—51.0 合金和 x=55.0—56.0 合金具有较大的 R 相变能力.

2.4 显微组织

2.4.1 固溶淬火组织 固溶淬火态 Ti-Ni 合金的 室温组织与 *x* 和 *T*_M 温度的关系如图 2 所示.可以看出 以下几点:

(1) x=40.0—49.0 合金的室温组织由 M+Ti₂Ni 组
 成. 其中 Ti₂Ni 分布在 M 晶界. 随 x 增加, Ti₂Ni 减
 少, M 量增多 (见图 2a 和 b).

(2) x=49.0—51.5 合金的室温组织差别很大. 例如, x=49.0 合金的 $T_{\rm M}$ 温度在室温以上, 组织是 M 相 (见图 2b), x=50.5 和 x=51.0 合金的 $T_{\rm M}$ 温度在室温以下, 组 织是 A 相 (见图 2c 和 d).

(3) *x*=52.0—70.0 合金的室温组织由 A 相和形态、 尺寸、分布和密度不尽相同的化合物组成,见图 2e-g.随 *x* 增加, A 相减少,化合物数量增多,尺寸增加,形态由 针、条状渐变为粗片状.

由于 x=52.0—70.0 合金中化合物比较复杂,本文用 SEM 和 EDXS 对固溶淬火态 x=53.0,56.0 和 65.0 的 3 种典型合金中的化合物进行了分析.结果表明, x=53.0



图 2 固溶淬火态 Ti–Ni 合金室温组织和 Ni 含量 x 的关系

Fig.2 Relationship between microstructure and x for solution-quenched $Ti_{100-x}Ni_x$ alloys at room temperature, showing with increasing x the microstructure changing from martensite (M) with Ti_2Ni to parent phase (A) to A with various Ti-Ni alloys

- (a) x=45.0 and (b) x=49.0, showing M with Ti₂Ni (c) x=50.5 and (d) x=51.0, showing A
- (e) x=53.0, showing A with needle-like Ti₂Ni₃ and spot-like TiNi₂
- (f) x=56.0, showing A with needle-like Ti₂Ni₃ and chain-like TiNi₂
- (g) x=65.0, showing A with large plate-like TiNi₃ and short staff-like TiNi₂

合金的组织中存在着针状和点状两种化合物,其中针状化 合物为 Ti₂Ni₃,分布在晶内;点状化合物为 TiNi₂,分布 在晶界和晶内. x=56.0合金中存在着针状 (Ti₂Ni₃)、 点状 (Ti₂Ni₃)和链状 (TiNi₂) 3种化合物,分布在晶内 或晶界. x=65.0合金中存在着大片状 (TiNi₃)和短杆 状 (TiNi₂)两种化合物.

2.4.2 时效组织 *x*=40.0—50.0 合金不存在时效 效应,时效处理后组织不发生变化. *x*=50.5—70.0 合 金具有时效效应,时效组织中产生了大量析出物.下面以 *x*=51.0 和 56.0 两种典型合金为例,研究时效态 Ti-Ni 合金的组织特征.

时效态 x=51.0 合金的析出物在 OM 下呈针状交叉 分布.图 3a 所示 SEM 照片给出了由晶界长入晶内的针状 析出物的形貌, EDXS 分析表明,该析出物为 Ti₃Ni₄.时 效态 x=56.0 合金的典型组织如图 3b 所示.可以看出,晶 内析出物呈点状和针状,晶界析出物呈链状. EDXS 分析 结果表明,点状析出物为 Ti₃Ni₄,针状析出物为 Ti₂Ni₃, 链状析出物为 TiNi₂. 析出物的分布规律是,晶内均匀分 布,晶界呈链形分布,越靠近晶界形态越复杂,分布越不 均匀.此外,在晶界附近存在着大片无析出物区,这是由 于**晶界处富** Ni 析出物形成时吸收了附近基体大量 Ni 原 子, 造成该区贫 Ni, 不具备析出物形成条件.

3 讨论

3.1 固溶淬火态 Ti-Ni 合金的相变行为

固溶淬火态 x=40.0—49.0 合金的组织为 M+Ti₂Ni, 随 x 增加, Ti₂Ni 相减少. 由于合金的 T_M 和 ΔT_M 的大 小与相变过程中所受的阻力有关,阻力越大, T_M越小, $\Delta T_{\rm M}$ 越大. Ti₂Ni 相分布在 A 相晶团周围, 对晶团内 的相变影响不大, 故 T_M , ΔT_M 与 x 无关. 而随 x 增加, Ti₂Ni 相减少, MT 量增加, 使 ΔH_M 升高. 固溶淬火 态 x=49.0—52.0 合金随 x 增加, A 相中 Ni 原子过饱 和度增加,晶格畸变增大,淬火时 MT 阻力加大,不仅使 相变推迟,而且使相变量减少,故 T_M 和 ΔH_M 急剧下 降. 又由于 x 对 T_M 的影响大于对 T_A 的影响, 使 ΔT_M 急剧升高. 固溶淬火态 x=52.0-56.0 合金随 x 增加, Ti_2Ni_3 和 $TiNi_2$ 等富 Ni 化合物数量增加, 吸收了基体 中部分 Ni 原子, A 相过饱和度减少,晶格畸变减轻,相 变阻力减弱,因而 $T_{\rm M}$ 和 $\Delta H_{\rm M}$ 升高, $\Delta T_{\rm M}$ 降低. 固溶 淬火态 x=56.0—70.0 合金随 x 增加, TiNi₂ 和 TiNi₃ 等块状富 Ni 化合物数量增加, A 相数量减少. 由于这 些化合物尺寸较大,对 MT 阻碍作用小,故 $T_{\rm M}$ 和 $\Delta T_{\rm M}$ 均变化不大,又由于参与 MT 的 A 相数量不断减少,使



图 3 时效态 Ti₄₉Ni₅₁ 和 Ti₄₄Ni₅₆ 合金中析出物的形态

- Fig.3 SEM morphologies of precipitates in aged Ti–Ni alloys
 - (a) $Ti_{49}Ni_{51}$ alloy, showing parent phase A with needle–like Ti_3Ni_4
 - (b) Ti₄₄Ni₅₆ alloy, showing parent phase A with spot-like Ti₃Ni₄, needle-like Ti₂Ni₃ and chainlike TiNi₂

ΔH_{M} 直线下降.

3.2 时效态 Ti-Ni 合金的相变行为

3.2.1 RT 行为 时效态 x=50.5—70.0 合金发 生 RT. 在 RT 的参量 $T_{\rm R}$, $\Delta T_{\rm R}$ 和 $\Delta H_{\rm R}$ 中, $T_{\rm R}$ 对 x不敏感, 对 $t_{\rm A}$ 敏感, 随 x 增加 $T_{\rm R}$ 保持不变, 随 $t_{\rm A}$ 延 长 $T_{\rm R}$ 缓慢增加; $\Delta T_{\rm R}$ 对 x 和 $t_{\rm A}$ 皆不敏感, 为一定 值; $\Delta H_{\rm R}$ 则对 x 和 $t_{\rm A}$ 都十分敏感. 产生上述现象的 原因是 RT 应力场弱,约为 MT 的 1/10^[16],与周围析出 物的相互作用力小、相变阻力小,相变温度和热滞比较稳 定.相变热取决于参与相变的母相的数量和相变所受到的 阻力等因素,而这些因素又受合金的成分和组织的影响.

如前所述,随着 x 的增加, x=50.5—70.0 合金中的析 出物会发生复杂变化,数量不断的增加, A 相不断的减 少,使 ΔH_{R} -x 呈"双峰"关系.随着 t_{A} 的延长,析出 物的尺寸增大,应力场减弱,对 RT 阻抑程度减少,导致 ΔH_{R} 增加.

3.2.2 MT 行为 时效态 *x*=40.0—50.0 合金不存 在时效效应,组织中无析出物,故 *T*_M, Δ*T*_M 和 Δ*H*_M 与 时效无关. 时效态 *x*=50.5—70.0 合金组织中存在 Ti₃Ni₄ 和 Ti₂Ni₃ 等析出物. 在时效初期, 这些析出物较为细小, 与母相保持共格关系并产生共格应力场^[17], 阻碍相变时 M/A 界面的移动, 推迟或抑制了 MT, 使 $T_{\rm M}$ 降低, 甚 至使 x=51.5-70.0 合金在 673 K 短时间时效后不发生 MT. 一方面, 随 $t_{\rm A}$ 延长, 析出物逐渐长大, 与母相失去 共格关系, 所产生的应力场下降, 对 MT 的抑制作用减 少, 使 $T_{\rm M}$ 和 $\Delta H_{\rm M}$ 升高. 另一方面, 析出物的形成造成 母相贫 Ni 亦可导致 $T_{\rm M}$ 升高, 由于 $T_{\rm M}$ 的升幅大于 $T_{\rm A}$ 的升幅, 故 $\Delta T_{\rm M}$ 下降.

3.3 Ti-Ni 合金的显微组织特点

Ni 含量和时效对 Ti-Ni 合金的组织影响很大. x=40.0-50.0 合金的组织具有成分效应,不具有时效效 应,其固溶淬火和时效组织相同,室温组织皆为 M+TiNi₂, 随 x 增加, TiNi₂ 减少. x=50.5-70.0 合金的组织既具 有成分效应,又具有时效效应,室温组织为 A + 析出物. 随 x 增加或 t_A 延长,组织中析出物的种类和数量增多. 析出物出现的先后顺序为 Ti₃Ni₄-Ti₂Ni₃-TiNi₂-TiNi₃, 稳定性以 Ti₃Ni₄-Ti₂Ni₃-TiNi₂-TiNi₃ 顺序增加.

由于 SME 与 M 相对应, SE 与 A 相对应, 因而 通过控制 *x* 便可控制室温组织,进而达到在室温下控制 SME 与 SE 的目的. 另外,析出物的数量、种类、形态和 分布不同,对相变温度和形状记忆行为会产生不同影响. 弥散均匀分布的 Ti₃Ni₄ 和 Ti₂Ni₃ 对 SME 十分有利, 与基体呈共格关系的 Ti₃Ni₄ 是产生双向和全方位 SME 的根源 ^[18].

此外,弥散分布的析出物可降低 T_M ,是产生 SE 的基础,而推迟 MT 还可使 R 相和 M 相相变分离,有利于获得热滞小、热循环和应力循环稳定性好的 RT,以制作反应灵敏、寿命长的形状记忆元件 ^[9].

4 结论

(1) 对于 Ti_{100-x}Ni_x 合金,固溶时效态 x=33.3 和 x=75.0 合金不发生相变;固溶淬火态 x=40.0-70.0 合 金和时效态 x=40.0-50.0 合金只发生 MT,不发生 RT; 时效态 x=50.5-70.0 合金既发生 MT,又发生 RT,其 中 x=51.5-70.0 合金 673 K 短时间 ($t_A \leq 1$ h) 时效后 不发生 MT.

(2) 固溶淬火态 $Ti_{100-x}Ni_x$ 合金中, x=40.0— 49.0 时, 合金的 T_M 和 ΔT_M 恒定不变, ΔH_M 升高; x=49.0-52.0 时, 合金的 T_M 和 ΔH_M 急剧下降, ΔT_M 急剧升高; x=52.0-56.0 时, 合金的 T_M 和 ΔH_M 升 高, ΔT_M 降低; x=56.0-70.0 时, 合金的 T_M 和 ΔT_M 基本上不变, ΔH_M 下降.

(3) 673 K 时效态 Ti_{100-x}Ti_x 合金中, x=40.0-50.0 时, 合金的 MT 不受时效影响. x=50.5-70.0 时, 合金的 MT 受时效影响很大, 随 t_A 延长, T_M 和 ΔH_M 先下降后上升, ΔT_M 下降. x=50.5-70.0 时, 合金发 生 RT. T_R 对 x 不敏感, 对 t_A 敏感, 随 x 增加 T_R 保持 敏感,为一定值; $\Delta H_{\rm R}$ 则对 x 和 $t_{\rm A}$ 都十分敏感.

(4) Ni 的含量和时效对 Ti-Ni 合金的组织有很大影响. x=40.0—50.0 合金的组织不受时效影响,室温组织为 M+TiNi₂,随着 x 增加, TiNi₂ 减少. x=50.5—70.0 合金的组织受时效影响很大,室温组织为 A + 析出物.
随着 x 的增加或 t_A 的延长,组织中析出物的种类和数量 增多.

参考文献

- [1] Miyazaki S, Otsuka K. Trans ISIJ, 1989; 25: 353
- [2] Honma T, Takei H. J Jpn Inst Met, 1975; 3: 175
- [3] Tang W, Sundman B, Sandstrom R, Qiu C. Acta Mater, 1999; 47: 3457
- [4] Todoroki T, Tamura H. Trans JIM, 1987; 28: 83
- [5] Huang X, Liu Y. Scr Mater, 2001; 45: 153
- [6] Lin H C, Wu S K. Metall Trans, 1993; 24A: 293

- [7] Jean R D, Tsai J C. Scr Metall Mater, 1994; 30: 1027
- [8] He Z R, Zhou J E. Acta Metall Sin, 2002; 38: 775 (贺志荣,周敬恩. 金属学报, 2002; 38: 775)
- [9] Miyazaki S, Igo Y, Otsuka K. Acta Metall, 1986; 34: 2045
- [10] McCormick P G, Liu Y. Acta Metall Mater, 1994; 42: 2407
- [11] Khalil Allafi J, Ren X, Eggeler G. Acta Mater, 2002; 50: 793
- [12] Otsuka K, Wayman C M. Shape Memory Materials. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 49
- [13] He Z R, Miyazaki S. Acta Metall Sin, 1996; 32: 351
 (贺志荣, 宫崎 修一. 金属学报, 1996; 32: 351)
- [14] He Z R, Zhang Y H, Xie N S. Phys Test Chem Analy, Part A: Phys Test, 1997; 33: 21
 (贺志荣,张永宏,解念锁.理化检验 - 物理分册, 1997; 33: 21)
- [15] Otsuka K, Ren X. Mater Sci Eng A, 1999; A273-275: 89
- [16] Miyazaki S, Otsuka K. Metall Trans A, 1986; 17A: 53
- [17] Wu S K, Lin H C, Chou T S. Acta Metall, 1990; 38: 95
- [18] Nishida M, Honma T. Scr Metall, 1984; 18: 1293